

Model SA series

量产型半自动/全自动探针台



- ☑ 超高的测试精度和超快测试速度
- ☑ 支持单点测试和连续测试
- ☑ 便捷的仪器接入
- ☑ 自动alignment/找晶圆中心/测量diesize
- ☑ 功能丰富的测试软件
- ☑ 可升级自动wafer厚度测量和ID读卡

Model SA series

规格

型号	SA-6/SA-8/SA-12		外形	1500 (长) * 1700 (宽) * 1100 (高)
重量	1700kg		电力需求/功率	220VAC±10V/50Hz/2.2KW
规格参数	能够测试的晶圆直径	6", 8", 12"		
	晶圆厚度	300≤T≤1000um (标准) 300≥T(薄片机型)		
	晶圆厚度偏差	±50um		
	Inlex time	300ms(标准速度, die尺寸 10mm, 包括Z上下0.3mm移动的时间)		
	Chuck 具备5轴移动机构	(X/Y/Z/theta/F)		
	X-Y轴行程	380mm, 最高速度300mm/s, 分辨率0.1um		
	XY全行程机械定位精度	± 2um (环境温度在±1℃以内波动时)		
	XY最大速度	300mm/s		
	chuck平面度	≤5 um		
	Z轴行程	37mm, 探针分离高度0.3mm, 速度 30毫秒/0.3mm		
	Z轴移动解析度	0.1um		
	Z轴定位精度	±2um		
	Theta轴行程/解析度	±5°/0.0001°		
	光栅尺	0.1um光栅尺		
	预对位平台	光学原理检测, 平边或者notch±1°定位精度		
	晶圆机械手	陶瓷机械手, cassette *1		
	晶圆装载单元	一个升降单元, 预对位单元, 晶圆传输子单元以及他们的接口		
	自动对位系统	自动水平扫描、自动第一测试点定位、自动测试中心定位		
	自动上下片系统	料盒安全保护、晶圆定位边预对准		
	精确对位单元	pattern matching		
	位移传感器	采用静电传感器, 分辨率 2um(option)		
	照明	同轴卤素灯照明或LED光源		
	视场	低倍情况: 4.9*3.6mm 中倍情况: 1*0.72mm 高倍情况: 0.49*0.36mm		
PC配置	I5CPU, 4G内存, 128G固态硬盘等			
LCD显示器	对位显示为黑白, 其他显示为彩色, 中文			
键盘	单元大小 15*15mm, 46 字母数字			
报警器(三色灯)	红, 黄, 绿			
操作场地要求	2200mmX2200mm			
操作界面	Windows中文操作界面, 中文MAPING动态显示			
标记	上下标记, 标记可以实时或者离线标记, 标记耗时15~300ms, 采用ink或者Laser			
可以采用的cassette形式	FOUP 12/8/6"(13或者25片); light FOUP 12/8/6"(13或者25片), 12/8/6" open cassette			
可选附件	自动磨针台	可以兼容高频测试头	晶圆ID 识别功能	
	可以匹配自动晶圆盒取放设备 (AGV or OHT)		直接和晶圆传输控制电脑或者服务器通讯	
"FOUP(front open unified Pod)有别于普通open cassette, 带有洁净气体单元 (mini environment), 可以在晶圆传输过程保持洁净在Class100洁净室里面, 探针台内部可以达到Class 1" 主体包括: 控制盒, TTL, RS232, GBIP测试机接口				

Model SA series

Mass Production Semi-automatic / Fully Automatic Probe Station



- ✓ Ultra high test speed and precision
- ✓ Automatic alignment, centering and die size testing
- ✓ Support for single point testing, and continuous testing
- ✓ Easy tester integration
- ✓ User friendly and Feature-rich software
- ✓ Wafer thickness Automatic test by displacement sensor

Model SA series

Specification	
Model	SA-6 / SA-8 / SA-12
Dimension	L 1500mm* W 1700mm*H 1100
Weight (about)	1700kg
Electricity Demand	220VAC±10V ,50Hz/2.2KW
Wafer diameter that can be measured	6", 8", 12"
Wafer thickness	300≤T≤1000μm (standard) T≤300(Thin wafer type)
Wafer thickness deviation	±50μm
Index time	280ms(standard speed) die size 10mm, include Z up/down 0.2mm)
Chuck with 5-axis moving mechanism	(X/Y/Z/theta/F)
X-Y Travel range	380mm, maximum speed 300mm/s, Resolution ratio 0.1μm
XY Mechanical positioning accuracy	±2μm
XY Maximum speed	300mm/s
Z Platform flatness	≤5 μm
Z Travel range	37mm, Probe separation height 0.3mm, Speed 30ms / 0.3mm
Z Moving resolution	0.1μm
Z Repeatability	±1μm
Z Precision	±2μm
Theta / Resolution	±5°/0.0001°
Grating ruler	0.1μm
Pre-alignment method	Optical principle detection, ±1° flat edge or notch positioning accuracy
Wafer loader	Ceramic Wafer loader, cassette*1
Wafer loading unit	lifting unit*1, pre-alignment unit*1, wafer transmission subunit*1, and interfaces
Automatic alignment system	Automatic horizontal scanning, automatic first test point location, automatic wafer center location
Automatic system for wafer exchange	Safety protection, wafer positioning edge pre-alignment
Matching unit	Pattern matching
Displacement sensor	Electrostatic capacitance sensor, resolution 2μm
Lighting	Coaxial halogen lamp lighting or LED light source
PC configuration	I5CPU, 4G memory, 128G Solid state hard drive, etc.
Alarm (tricolour lamp)	Red, Yellow, Green
Operating site requirements	2200mm * 2200mm
Operation system	Windows operation interface, English/Chinese language
Mark	Quantity : 1pcs
Marking mode	Up and down, the mark can be marked in real time or offline, the marking time is 15 ~ 300ms, ink mark/laser mark
Cassette that can be used	FOUP 12"8"/6" (13 or 25pcs), light FOUP 12"8"/6" (13 or 25pcs), open cassette 12"8"/6"
Optional Accessories	Automatic probe needle cleaning table
	RF high frequency test
	VCR for Wafer ID reading
	Matching the automatic wafer AGV or OHT design
	High power wafer test